

LEADED SOLDER

FC63-BZ(L) スタンダードタイプ

はんだボールを低減し、安定した印刷が可能です。
廃棄ソルダペーストの削減に貢献します。

Fine Solder



Product Features 製品特性

■ はんだボールを大幅に低減

独自のフラックス技術によりプリヒート時のスランブ(部品下やランド外への流れ出し)を抑制することで、はんだボールの発生を削減することが可能になりました。



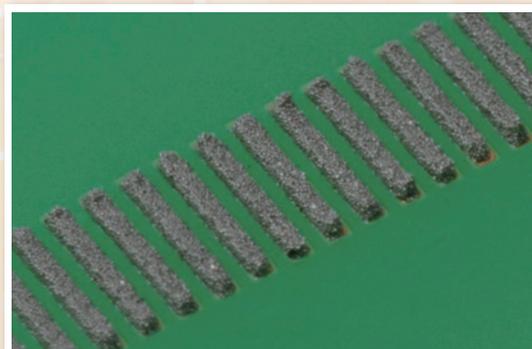
FC63-BZ(L)



● 他社相当品 ●

■ 印刷安定性が良好

常温において非常に安定な活性剤を使用しているため、長時間の印刷作業(ローリング)でも安定した印刷性能を発揮し廃棄ソルダペーストの削減に貢献します。



○ QFP ○

項目	FC63-BZ(L)	試験規格
合金組成	Sn63%-Pb37%	JIS Z3282
固相線温度	約183℃	JIS Z3282
液相線温度	約183℃	JIS Z3282
はんだ粉末サイズ	20~38 μ m (Type4)	JIS Z3284(J-STD-005)
フラックス含有量	10.2%	JIS Z3197
ハライド含有量	0.05%	JIS Z3197
粘度特性	190Pa·s	JIS Z3284
チクソトロピー指数	0.56	JIS Z3284
銅板腐食試験	合格	JIS Z3197
絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)	5.0 \times 10 $^{\circ}$ Ω 以上	JIS Z3197
マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)	異常なし	JIS Z3197
広がり率	96%	JIS Z3197

